



[kingston.com/emcp](http://kingston.com/emcp)

## eMCP

**идеальное энергосберегающее интегрированное решение для хранения данных в мобильных устройствах, устройствах Интернета вещей и встраиваемых системах с ограниченным пространством**

Компания Kingston предлагает линейку компонентов eMCP, соответствующих стандарту JEDEC. Компоненты eMCP объединяют встраиваемую мультимедийную карту (eMMC) и модуль Low-Power Double Data Rate (LPDDR) DRAM в многокристальном корпусе (MCP), отличающемся малым размером. Это решение обеспечивает более высокую степень интеграции, уменьшая общий размер. eMCP — это идеальный комбинированный компонент, объединяющий хранилище и память, для систем с ограниченным пространством, таких как смартфоны, планшеты, носимые устройства и различные устройства «Интернета вещей» (IoT).

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Управляемое решение на основе флеш-памяти NAND, упрощающее проектирование и поддержку продукта благодаря интерфейсу eMMC, являющемуся отраслевым стандартом. Оно значительно снижает сложность проектирования и сокращает этап оценки качества продукции.
- Сочетание памяти и хранилища с высокой степенью интеграции сокращает занимаемое пространство в системе, что делает eMCP идеальным решением для сфер применения с малым форм-фактором.
- Память DRAM с низким энергопотреблением снижает общее энергопотребление, благодаря чему компоненты eMCP отлично подходят для многих устройств с питанием от аккумуляторов, таких как носимые устройства и мобильные устройства Интернета вещей.
- Сокращение количества компонентов снижает сложность спецификации материалов.
- Доступно несколько конфигураций встроенного ПО, которые наилучшим образом соответствуют требованиям вашей области применения к производительности, мощности и сроку службы.

## РЫНОЧНЫЕ СЕГМЕНТЫ



Смартфоны и Планшеты



Носимые устройства



Нейроускорители



Интернет вещей

## НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ И СПЕЦИФИКАЦИИ eMCP

### eMCP НА ОСНОВЕ LPDDR3

Номер по каталогу	Емкость		Стандарт		Корпус	FBGA	Рабочая температура
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EM04-N3GM627	4	4	5.0	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	От -25 до +85°C
08EM08-N3GML36	8	8	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	От -25 до +85°C
16EM08-N3GTB29	16	8	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	От -25 до +85°C
16EM16-N3GTB29	16	16	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	От -25 до +85°C
32EM16-N3GTX29	32	16	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	От -25 до +85°C
32EM32-N3HTX29	32	32	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,1	221	От -25 до +85°C
64EM32-N3HTX29	64	32	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,1	221	От -25 до +85°C

### eMCP baseada em LPDDR4x

Номер по каталогу	Емкость		Стандарт		Корпус	FBGA	Рабочая температура
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EM08-M4EM627	4	8	5.1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	149	От -25 до +85°C
16EM16-M4CTB29	16	16	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	От -25 до +85°C
32EM16-M4CTX29	32	16	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	От -25 до +85°C
32EM32-M4DTX29	32	32	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	От -25 до +85°C
64EM32-M4DTX29	64	32	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	От -25 до +85°C
128EM32-M4DTX29	128	32	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,1	254	От -25 до +85°C

